

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2022-001

苏州晶方半导体科技股份有限公司 2021年年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、经苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 55,200 万元至 57,500 万元，同比增长 44.65%至 50.67%。

2、扣除非经常性损益事项后，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 46,000 万元至 48,000 万元，同比增长 39.80%至 45.88%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 55,200 万元至 57,500 万元，同比增长 44.65%至 50.67%。

2、扣除非经常性损益事项后，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 46,000 万元至 48,000 万元，同比增长 39.80%至 45.88%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：38,161.67 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：32,903.04 万元。

(二) 每股收益：1.19 元。

三、本期业绩预增的主要原因

公司封装订单快速增长,产能与生产规模显著提升。封装工艺持续拓展创新,汽车电子等新应用领域量产规模不断提升,中高像素产品逐步实现量产、Fan-out 技术在大尺寸高像素领域的量产规模持续扩大、晶圆级微型镜头业务商业化应用规模不断提升。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 14 日